

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的  
第二轮审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2019]004226 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

和舰芯片制造（苏州）股份有限公司  
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮  
审核问询函中有关财务事项的回复

	目 录	页 次
一、	首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函中有关财务事项的回复	1-35



## 首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮 审核问询函中有关财务事项的回复

大华核字[2019]004226 号

上海证券交易所:

由长江证券承销保荐有限公司转来的《关于和舰芯片制造（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（审核）[2019]131号，以下简称第二轮审核问询函）奉悉。我们已对第二轮审核问询函所提及的和舰芯片制造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”“和舰芯片”或“发行人”）财务事项进行了审慎核查，现回复如下：

### 一、第二轮审核问询函 3. 关于控制厦门联芯以及将厦门联芯纳入合并报表范围

招股说明书及问询回复中披露了以下事项：（1）厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务由联华电子或通过其子公司联华微芯履行，回购义务不涉及发行人及其子公司厦门联芯；（2）发行人拟尽快将产能提高到 5 万片/月，通过规模效应降低单位成本，早日实现扭亏为盈，而 5 万片完全达产预计还需要投资生产设备约 155 亿人民币；（3）联华电子出具确认函：确认联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不可撤销地全权委托发行人行使；（4）董事会是厦门联芯的最高权力机构，决定厦门联芯的一切重大问题，厦门联芯董事会一共 9 名董事，其中三分之二由发行人委派，故发行人能控制厦门联芯董事会，报告期内，发行人委派至厦门联芯的董事包括：尤朝生、简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017 年 2 月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018 年 11 月离任）八人。根据联华电子在台湾证券交易所披露的股东会年报显示，除尤朝生之外，其余 7 人都在联华电子或其关联方任职。

请发行人披露：1、对厦门联芯达到满产 5 万片/月需要增加的约 155 亿投资资金来源及预计投资的具体时间安排，追加设备投资后预计产生的折旧摊销情况，并量化分析对发行人未来业绩的具体影响；2、需要追加的 155 亿资金投入是否由联华电子对厦门联芯进一步追加，发行人在厦门联芯的股权比例是否会因此被进一步稀释，是否会影响厦门联芯的生产经营决策机制；

3、联华电子或联华微芯对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务预计完成时间，回购完成后厦门联芯的股权结构，并结合回购完成后的联华电子持股比例进一步提高的情况，说明联华电子对厦门联芯的控制力是否将进一步增强；4、厦门联芯的进一步投资是否依赖联华电子的资金投入，并结合厦门联芯主要制程技术都来源于联华电子授权的情况，分析并披露厦门联芯是否依赖于联华电子；结合芯片制造为资金和技术密集型的行业、联华电子内部对发行人以及厦门联芯具体管理方式，分析并披露发行人在厦门联芯生产经营中所起的作用，以及是否为关键作用，是否能主导厦门联芯的生产经营决策，发行人是否作为联华电子的代理或授权代理，管理厦门联芯，发行人在厦门联芯承担的责任与最终可以取得的收益是否能够匹配；5、报告期内，简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017年2月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018年11月离任）七人在联华电子及其关联公司内的具体任职和领薪情况；6、发行人对厦门联芯派驻董事人选如何确定，是否出于联华电子的授意，发行人在厦门联芯委派董事是否为名义由其委派，实际由联华电子或其关联方委派或控制，请补充提供相关内部决策文件；结合派驻在厦门联芯的6名董事中的5名都主要在联华电子任职并领薪，特别是部分董事在联华电子内部的职级明显高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生的情况，分析发行人如何能实质上控制厦门联芯的董事会；7、结合联华电子将表决权不可撤销的委托给发行人，但实际派驻厦门联芯的董事主要为联华电子员工的情形，分析相关授权的实际执行情况；8、结合以上事项以及《企业会计准则》中关于控制的定义，说明公司将厦门联芯纳入合并报表范围是否符合《企业会计准则》的要求。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，说明核查手段、核查方式和过程，并结合发行人持有厦门联芯股份比例不足15%，厦门联芯董事主要为联华电子员工等情况，对发行人是否控制厦门联芯及将厦门联芯纳入合并报表是否依据充分发表明确意见。

回复：

（一）对厦门联芯达到满产5万片/月需要增加的约155亿投资资金来源及预计投资的具体时间安排，追加设备投资后预计产生的折旧摊销情况，并量化分析对发行人未来业绩的具体影响

1、厦门联芯达到满产5万片/月需要增加的约155亿投资资金来源及预计投资时间安排如下：

资金来源	金额	投入时间
自有资金	46.5 亿元	2019 年至 2024 年，根据实际需要随时投入
银行借款	46.5 亿元	2019 年至 2024 年，根据实际需要向银行借款
发行人和其他股东资本金投入	62 亿元	2020 年至 2024 年
合计	155 亿元	-

其中，发行人和联华电子资本金投入的规划如下：

投资时间	其他股东出资	发行人
2020 年 6 月 30 日	9 亿元	1.5 亿元

2021年6月30日	9亿元	1.5亿元
2022年6月30日	12亿元	2亿元
2023年6月30日	14.5亿元	2.5亿元
2024年6月30日	8.5亿元	1.5亿元
合计	53亿元	9亿元

## 2、追加设备投资后预计产生的折旧摊销情况，对发行人未来业绩产生的具体影响

2019年至2024年为厦门联芯追加设备投资的期间。追加的设备自2019年开始产生折旧，并于2030年全部折旧完毕。该期间追加的设备产生的年均营业收入为57亿元，年均折旧15亿元。

### （二）需要追加的155亿资金投入是否由联华电子对厦门联芯进一步追加，发行人在厦门联芯的股权比例是否会因此被进一步稀释，是否会影响厦门联芯的生产经营决策机制

厦门联芯的进一步投资的155亿元主要依靠自有资金、银行借款和发行人和其他股东包括联华微芯的资本金的投入，其中发行人在厦门联芯的股权比例不会被稀释，由于联华微芯将厦门联芯的表决权不可撤销的委托给发行人，发行人能够继续控制厦门联芯的董事会和生产经营，因此厦门联芯的生产经营决策机制不会受到影响。

### （三）联华电子或联华微芯对厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购义务预计完成时间，回购完成后厦门联芯的股权结构，并结合回购完成后的联华电子持股比例进一步提高的情况，说明联华电子对厦门联芯的控制力是否将进一步增强

和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团四方于2016年12月签署的《合资合营合同》约定，厦门金圆、福建电子集团出资的资本金，从其资本金到账后第7年开始，由发行人/联华微芯按60%、20%、20%的比例分三次在连续三年完成全部回购。如果届时台湾地区仍然规定发行人/联华微芯不能在大陆地区独资经营，则发行人/联华微芯可以选择由厦门金圆、福建电子集团继续持有厦门联芯合计10%的注册资本（资本金），即对该10%的注册资本（资本金）不予回购。

厦门金圆、福建电子创业投资投入厦门联芯的资本金到位时间为2016年7月，根据上述协议的约定，联华电子或联华微芯回购义务预计完成的时间为2024年7月。

如果联华电子或联华微芯回购厦门金圆、福建电子创业投资持有厦门联芯的全部股权后，厦门联芯的股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	实缴比例
和舰芯片	184,026.00	14.49%
联华微芯	1,085,753.40	85.51%
合计	1,269,779.40	100%

如果因台湾地区仍然规定发行人/联华微芯不能在大陆地区独资经营，厦门金圆、福建电子创业投资继续持有厦门联芯合计 10%的注册资本（资本金），即联华电子或联华微芯对该 10%的注册资本（资本金）不予回购，厦门联芯的股权结构如下：

股东名称	实收资本（万元）	实缴比例
和舰芯片	184,026.00	14.49%
联华微芯	958,775.46	75.51%
厦门金圆、福建电子创业投资	126,977.94	10.00%
合计	1,269,779.40	100.00%

虽然联华电子回购厦门金圆、福建电子创业投资持有厦门联芯的股权后，联华电子持有厦门联芯的股权比例进一步提高，但联华电子已将表决权不可撤销委托给和舰芯片，并且厦门联芯的董事仍由和舰芯片委派，厦门联芯的经营管理权由和舰芯片控制，和舰芯片仍控制厦门联芯。

**（四）厦门联芯的进一步投资是否依赖联华电子的资金投入，并结合厦门联芯主要制程技术都来源于联华电子授权的情况，分析并披露厦门联芯是否依赖于联华电子；结合芯片制造为资金和技术密集型的行业、联华电子内部对发行人以及厦门联芯具体管理方式，分析并披露发行人在厦门联芯生产经营中所起的作用，以及是否为关键作用，是否能主导厦门联芯的生产经营决策，发行人是否作为联华电子的代理或授权代理，管理厦门联芯，发行人在厦门联芯承担的责任与最终可以取得的收益是否能够匹配**

**1、厦门联芯的进一步投资是否依赖联华电子的资金投入，并结合厦门联芯主要制程技术都来源于联华电子授权的情况，分析并披露厦门联芯是否依赖于联华电子**

厦门联芯的进一步投资的 155 亿元主要依靠自有资金、银行借款和发行人和其他股东包括联华微芯的资本金的投入，由于 12 英寸晶圆厂投资太大，发行人需要借助联华电子的资金实力对厦门联芯进行投资，但是联华微芯投资占规划投资总额比例不高，厦门联芯的进一步投资来源主要不是联华电子的资本金投入。

为了快速提高我国芯片制造技术水平和降低研发风险，12 英寸相关技术主要来自联华电子授权。厦门联芯取得的联华电子授权的技术是完整技术，厦门联芯通过在引进吸收的基础上进行客制化和特色工艺研发，已完全掌握联华电子授权的最先进制程技术，并且完全有能力进行特色工艺的研发，完全可以满足现阶段生产经营的需要，已对联华电子的技术不存在重大依赖。

因此，厦门联芯的进一步投资的 155 亿元主要依靠自有资金、银行借款和发行人及其他股东包括联华微芯的资本金的投入，厦门联芯的进一步投资来源主要不是联华电子的资

本金投入；厦门联芯已完全掌握厦门联芯授权的最先进制程技术，完全可以满足现阶段生产经营的需要，已对联华电子的技术不存在重大依赖。

**2、结合芯片制造为资金和技术密集型的行业、联华电子内部对发行人以及厦门联芯具体管理方式，分析并披露发行人在厦门联芯生产经营中所起的作用，以及是否为关键作用，是否能主导厦门联芯的生产经营决策，发行人是否作为联华电子的代理或授权代理，管理厦门联芯，发行人在厦门联芯承担的责任与最终可以取得的收益是否能够匹配**

联华电子为发行人的最终控股股东，发行人控制厦门联芯，发行人作为联华电子的子公司统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业，联华电子对厦门联芯只进行资本金投入和技术的授权并收取相应的费用。

发行人是 2013 年被联华电子收购，被收购前已经建立了完整的研发、生产、采购、销售体系，被收购后发行人依然保持以前的产供销体系，发行人已建立健全了股东会、独立的董事会及下属专门委员会、监事会以及高级管理层等现代公司治理机制，决策公司的重大事项和日常生产经营管理。

发行人作为联华电子的子公司，统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业，厦门联芯 2016 年建成投产后，其实际经营仍由和舰芯片负责。

报告期内，谈文毅一直担任厦门联芯的总经理；报告期初至 2017 年 1 月，厦门联芯的财务负责人为林荣常，2017 年 2 月至今，厦门联芯的财务负责人为朱伟杰，上述三人均为发行人委派。而根据公司章程的规定，总经理负责厦门联芯的日常经营管理，厦门联芯的管理团队向总经理汇报，并在总经理监督及指示下制定管理制度。厦门联芯设立以来未设置专门的销售部门，其销售完全由发行人负责，人力、采购、环安、厂务、财务等部门负责人均由发行人委派。因此发行人能够在厦门联芯的生产经营中起关键作用，能够主导厦门联芯的经营及财务决策等。

发行人能够控制厦门联芯董事会及经营管理团队，自主决定厦门联芯重大经营活动及财务决策，发行人作为联华电子控股子公司其利益与联华电子一致，符合股东利益最大化原则。发行人作为联华电子的子公司统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业，属于实质管理，不属于代理人角色。

发行人对厦门联芯拥有超过半数以上的表决权，能够通过对董事会和实际经营管理的影响获取相应的回报，并且有能力运用对厦门联芯的权力影响其回报金额，发行人借助其他股东资金实力按照发行人的战略规划使厦门联芯做大做强，提高自身的市场影响力并从

中获益。根据厦门联芯《公司章程》、《合资合营合同》，各股东遵循“利益共享、风险共担”的原则，发行人按照持股比例享受厦门联芯投资收益与承担相应的投资风险。

**（五）报告期内，简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017年2月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018年11月离任）七人在联华电子及其关联公司内的具体任职和领薪情况**

1、报告期内，简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017年2月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018年11月离任）七人在联华电子及其关联公司内的具体任职情况

序号	姓名	兼职单位	兼任职务	与发行人关联关系
1	林俊宏	联华电子	财务处处长	最终控股股东
		联相光电	董事	联华电子、宏诚投资、弘鼎投资合计持股 93.36%
		联旭能源	董事	联华电子子公司宏诚投资持股 100%
		冠铨香港股份有限公司	董事	联华电子子公司宏诚投资持股 25.14%
		永盛香港	董事	联华电子孙公司联旭能源持股 100%
		迅捷投资	董事	联华电子的法人董事
		UMC TECHNOLOGY JAPAN CO., LTD.	董事	联华电子子公司 OMNI 持股 100%
		菁英国际	董事	联华电子持股 100%
		弘鼎投资	监察人	联华电子持股 100%
		联京光电	2016年4月至2018年12月任董事	联华电子子公司宏诚投资原持股 83.69%，宏诚投资在2018年12月将持有的该公司股权全部转让
	SOCIALNEX ITALIA 1 S.R.L.	2017年3月至2018年11月任董事	联华电子持股 100%	
2	王文杰	联华电子	会计处处长	最终控股股东
		菁英国际	董事	间接控股股东
		矽统科技	董事	联华电子的法人董事(代表人：王石)
3	简山杰	联华电子	总经理	最终控股股东
		宏诚投资	董事	联华电子持股 100%
		联颖光电	董事	联华电子、宏诚投资合计持股 78.47%
		UMC CAPITAL CORP.	董事	联华电子持股 100%
		弘鼎投资	董事	联华电子持股 100%
4	陈进双	联华电子	副总经理兼人资长	最终控股股东
		菁英国际	董事	间接控股股东
5	许志清	联华电子	副总经理	最终控股股东
6	廖木良	联华电子	副总经理	最终控股股东
7	黄柏文	联华电子	专案处长 (2018年11月离任)	最终控股股东



2、简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良（2017年2月离任）、陈进双、许志清、黄柏文（2018年11月离任）七人在联华电子及其关联公司内的领薪情况

序号	姓名	2018年度	2017年度	2016年度
1	林俊宏	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子、弘鼎投资领薪 327.62 万新台币	在联华电子领薪 302.50 万新台币	在联华电子领薪 297.62 万新台币
2	王文杰	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子、矽统科技领薪合计 326.38 万新台币	在联华电子、矽统科技领薪合计 332.70 万新台币	在联华电子、矽统科技领薪合计 329.38 万新台币
3	简山杰	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子领薪合计 977.32 万新台币	在联华电子领薪合计 1,110.67 万新台币	在联华电子领薪合计 1,000.34 万新台币
4	陈进双	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子领薪合计 682.27 万新台币	在联华电子领薪合计 806.54 万新台币	在联华电子领薪合计 757.52 万新台币
5	许志清	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子、联电新加坡及联芯领薪合计 1,152.38 万新台币	在联电新加坡及联芯领薪合计 1,266.97 万新台币	在联华电子、联电新加坡及联芯领薪合计 1,202.29 万新台币
6	廖木良	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子领薪合计 652.69 万新台币	在联华电子领薪合计 743.81 万新台币	在联华电子领薪合计 761.72 万新台币
7	黄柏文	除联华电子库藏股认购利得和认购签约金外，在联华电子领薪合计 154.91 万新台币	在联华电子领薪合计 214.32 万新台币	在联华电子领薪合计 345.43 万新台币

（六）发行人对厦门联芯派驻董事人选如何确定，是否出于联华电子的授意，发行人在厦门联芯委派董事是否为名义由其委派，实际由联华电子或其关联方委派或控制，请补充提供相关内部决策文件；结合派驻在厦门联芯的 6 名董事中的 5 名都主要在联华电子任职并领薪，特别是部分董事在联华电子内部的职级明显高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生的情况，分析发行人如何能实质上控制厦门联芯的董事会

1、发行人对厦门联芯派驻董事人选如何确定，是否出于联华电子的授意，发行人在厦门联芯委派董事是否为名义由其委派，实际由联华电子或其关联方委派或控制，请补充提供相关内部决策文件；

（1）发行人对厦门联芯派驻董事人选的确定

联华电子是本公司的最终控股股东，发行人控制厦门联芯，发行人作为联华电子的子公司统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业，发行人的利益与联华电子一致。发行人对厦门联芯委派董事程序为：发行人拟定委派董事名单，并向联华电子报备，然后由发行人出具董事委派书。发行人对厦门联芯委派董事不存在由联华电子授意，或者以发行人名义委派而实际由联华电子或其关联方委派或控制的情形。

（2）相关内部决策文件

在股份公司设立之前，发行人只是通过出具董事委派书或者厦门联芯通过股东会的方式向厦门联芯派驻董事。具体情况如下：

A、在 2015 年 2 月至 2017 年 1 月，尤朝生、黄柏文、王文杰、廖木良、陈进双、许志清由发行人委派，厦门联芯于 2015 年 1 月 23 日召开股东会通过该事项；

B、2017 年 2 月，发行人将厦门联芯委派的董事由廖木良变更为简山杰时，并向委派董事出具了董事委派书；

C、2018 年 6 月，厦门联芯的董事陈进双、许志清由联华微芯改为发行人委派时，发行人向委派董事出具了董事委派书。

在股份公司成立之后，公司的法人治理结构和内部控制制度得到进一步完善，发行人在向厦门联芯派驻董事时，均履行了内部的核决程序，并向相关董事出具董事委派书。具体情况如下：

A、2018 年 11 月，发行人将派驻厦门联芯的董事由黄柏文改为林俊宏时履行了内部的核决程序，发行人向委派董事出具了董事委派书；

B、2019 年 5 月 21 日，发行人将厦门联芯委派的董事由简山杰、陈进双变更为高明正、林伟圣时，发行人履行了内部核决程序，并向委派董事出具了董事委派书。

**2、结合派驻在厦门联芯的 6 名董事中的 5 名都主要在联华电子任职并领薪，特别是部分董事在联华电子内部的职级明显高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生的情况，分析发行人如何能实质上控制厦门联芯的董事会**

发行人派驻厦门联芯的 6 名董事中，厦门联芯有 3 名董事在发行人处任职，其中尤朝生任副董事长兼财务负责人，林俊宏自 2018 年 6 月在发行人担任董事，王文杰自 2009 年起至今均在发行人处任监事。为进一步优化厦门联芯董事会结构，2019 年 5 月 21 日，发行人将向厦门联芯委派的董事由简山杰、陈进双变更为高明正、林伟圣，高明正为发行人董事、总经理，林伟圣为发行人副总经理。

发行人负责联华电子在大陆地区晶圆代工业务的统一管理，发行人委派至厦门联芯的董事无论其任职在联华电子或者和舰芯片，均有共同的利益诉求，其在联华电子体系内职位的高低不影响其在董事会中代表和舰芯片的利益，均符合委派人和舰芯片的最终利益诉求。发行人派驻厦门联芯的部分董事在联华电子内部的职级虽然高于发行人委派至厦门联芯董事长尤朝生，但董事对公司重大经营事项的决策是通过董事会行使职权得以实现的，

其职权是董事会的集体权力，不属于个别董事，但这部分董事均由发行人委派，发行人能够自主决定派驻董事的人选，在厦门联芯召开董事会对相关事项进行表决时，这部分董事均以发行人的意思为准，均是代表发行人的利益，与联华电子的最终利益不会产生冲突。因此发行人仍对厦门联芯的董事会进行实质控制。

**(七) 结合联华电子将表决权不可撤销的委托给发行人，但实际派驻厦门联芯的董事主要为联华电子员工的情形，分析相关授权的实际执行情况**

为保障联华电子透过联华微芯与发行人采取一致行动，2018 年 7 月，联华电子出具了《确认函》，确认联华微芯将表决权不可撤销地全权委托发行人行使。

2018 年 7 月 24 日，厦门联芯召开董事会，同意对《厦门联芯章程》、《合资合营合同》予以修订，新增、修订的内容如下：A、原由联华微芯指派的两席董事，改由发行人指派。B、原规定由发行人或联华微芯指派的一席监事，改由发行人指派。此外《合资合营合同》还增加“厦门联芯存续期间，若涉及股东行使表决权的事项，如增资、减资、修改厦门联芯章程、变更公司组织形式或厦门联芯运营中涉及的重大事项等，联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不可撤销的全权委托给发行人行使”的内容。《厦门联芯章程》、《合资合营合同》的上述修订已报厦门联芯商务主管部门、工商主管部门审批或备案。

2018 年 7 月至今，发行人委派董事席位恢复至 6 席，联华电子不再委派董事，发行人现任副董事长兼财务负责人尤朝生先生一直兼任厦门联芯董事长。截至本回复出具之日，厦门联芯的的董事尤朝生、林俊宏、王文杰、简山杰、陈进双、许志清均由和舰芯片委派。

自 2018 年 7 月以来，虽然实际派驻厦门联芯的董事主要为联华电子员工，但是他们均以发行人的意思为准，代表发行人的利益，在厦门联芯的董事会均一致表决，具体情况如下：

序号	召开日期	会议名称	决议内容	和舰芯片委派董事表决情况
1	2018 年 10 月 18 日	第一届第十次会议	资本支出预算和银行授信	一致表决
2	2018 年 11 月 12 日	临时董事会	董事变更	一致表决
3	2018 年 12 月 11 日	第一届董事会第十一次会议	资本支出预算和银行授信	一致表决
4	2018 年 12 月 25 日	临时董事会	采购机器设备	一致表决
5	2019 年 3 月 4 日	第一届董事会第十二次会议	营业预算、资本支出等	一致表决

厦门联芯的总经理谈文毅、财务负责人朱伟杰均为和舰芯片委派，厦门联芯的销售完全由和舰芯片负责，人力、采购、环安、厂务、财务等部门负责人均由和舰芯片委派。

综上，联华电子将表决权不可撤销的委托给发行人的事项，已在《公司章程》、《合营合同》予以体现，厦门联芯的董事会中原由联华微芯指派的两席董事，改由发行人指派，并且上述情况经厦门联芯商务主管部门、工商主管部门审批或备案，自联华电子委托表决权以来，即使发行人派驻的董事主要为联华电子员工，但在厦门联芯的历次董事会上均以发行人的意思为准，代表发行人的利益并且一致表决，厦门联芯的总经理、财务负责人和销售人力、采购、环安、厂务等部分的负责人均由和舰芯片委派。相关授权实际执行情况有效并且良好，和舰芯片能够对厦门联芯进行控制。

#### **（八）结合以上事项以及《企业会计准则》中关于控制的定义，说明公司将厦门联芯纳入合并报表范围是否符合《企业会计准则》的要求**

根据企业会计准则的相关规定，控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。发行人实质控制厦门联芯主要体现在：

##### **1、和舰芯片拥有对厦门联芯的权力**

（1）2013年2月联华电子取得和舰有限控制权后，为发挥和舰有限在大陆经营管理优势，统一经营管理联华电子在中国大陆芯片制造产业。2015年2月和舰有限出资控股厦门联芯。考虑地方政府对外商投资的政策支持，且因为12英寸晶圆厂投资太大，2017年1月和12月发行人将厦门联芯50.7246%出资权转让给联华电子全资孙公司联华微芯，发行人借助联华电子的资金实力对厦门联芯进行投资，2018年7月联华电子确认，在厦门联芯历次股东会上对相关事项的表决中，联华电子（透过联华微芯）与发行人采取了一致行动，且以发行人的意思表示为准，联华微芯将表决权不可撤销地全权委托发行人行使，因此，和舰芯片自2015年2月对厦门联芯出资以来，从表决权上对厦门联芯一直具有控制权。

（2）报告期内，厦门联芯的大部分董事会成员主要由发行人委派，虽然委派的董事主要为联华电子员工，但在厦门联芯的历次董事会上均以发行人的意思为准，代表发行人的利益并且一致表决。发行人副董事长一直兼任厦门联芯董事长，因此发行人能够通过控制厦门联芯的董事会对厦门联芯进行控制。

发行人对厦门联芯重大事项的决策有实质超过半数以上的表决权，拥有对厦门联芯的权力。

## 2、发行人对于投资厦门联芯享有可变回报

根据厦门市人民政府、联华电子、福建省电子集团于 2014 年签订的《参股协议书》及相关各方于 2018 年 7 月修订的《合资合营合同》、《厦门联芯章程》的规定，《参股协议书》、《合资合营合同》、《厦门联芯章程》虽未对盈亏承担予以具体约定，但确定了“利益共享，风险共担”原则，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》规定，在合营企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。合营各方按注册资本比例分享利润和分担风险及亏损。合营者的注册资本如果转让必须经合营各方同意”规定，四方股东应按照出资比例进行分红或承担亏损。

发行人按照出资比例进行分红或者承担亏损，取得的回报随着厦门联芯的业绩变动而变动，对厦门联芯享有可变回报。

## 3、发行人有能力运用对厦门联芯的权力影响回报

发行人对厦门联芯有能力影响其回报金额，对其相关经营活动进行决策时有可执行权利，发行人副董事长兼财务负责人尤朝生先生一直兼任厦门联芯董事长，且发行人指定任命和委派了厦门联芯总经理、财务负责人等高管以及人力、采购、环安、厂务等主要部门负责人，根据厦门联芯公司章程的规定，总经理负责厦门联芯的日常经营管理，厦门联芯的管理团队向总经理汇报，并在总经理监督及指示下制定管理制度。厦门联芯自设立以来未设置专门的销售部门，其销售完全由发行人负责。即实际负责厦门联芯的运营，主导厦门联芯的商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

发行人通过全方位的参与对厦门联芯的经营决策和具体事务的管理，有能力运用对厦门联芯的权利影响回报金额。

## 4、发行人在控制厦门联芯的决策过程中不属于代理人角色

发行人和联华微芯均同受联华电子控制，报告期各期末合计持有厦门联芯股权比例分别为：29.41%、51.02%、65.22%，根据《厦门联芯章程》、《合资合营合同》的相关规定，实际享有厦门联联芯的决策权。

根据联华电子出具“确认函”确认，在厦门联芯的重大事项的决策上，联华电子（透过联华微芯）委派的董事与发行人委派的董事采取了一致行动并以发行人委派的董事的意思表示为准；联华电子（透过联华微芯）作为厦门联芯的股东，在厦门联芯股东会上，联华电子（透过联华微芯）与发行人采取了一致行动，且以发行人的意思表示为准。联华微芯作为厦门联芯的股东，其表决权不

可撤销地全权委托发行人行使。和舰芯片作为联华电子子公司，与联华电子实际利益一致，联华电子通过控制发行人的相关决策过程，能够实现控制厦门联芯。

发行人相对于联华电子资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立、技术独立，能够独立对厦门联芯作出经营、财务决策，实施各项管理事务，不属于代理人角色。

综上，发行人对厦门联芯重大事项的决策有实质超过半数以上的表决权，拥有对厦门联芯的权力；发行人按照出资比例进行分红或者承担亏损，取得的回报随着厦门联芯的业绩变动而变动，对厦门联芯享有可变回报；发行人通过全方位的参与对厦门联芯的经营决策和具体事务的管理，有能力运用对厦门联芯的权利影响回报金额；发行人能够独立的对厦门联芯作出经营及财务决策，实施各项管理事务，不属于代理人角色。因此，能够在具体的经营管理过程中对厦门联芯进行控制，将厦门联芯纳入发行人合并报表范围符合《企业会计准则》的规定。

**（九）请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，说明核查手段、核查方式和过程，并结合发行人持有厦门联芯股份比例不足 15%，厦门联芯董事主要为联华电子员工等情况，对发行人是否控制厦门联芯及将厦门联芯纳入合并报表是否依据充分发表明确意见**

### **1、申报会计师核查程序及过程**

（1）审阅厦门联芯的工商档案资料、公司章程及相关协议，了解股东认缴出资比例及实际出资情况；

（2）审阅厦门联芯董事会决议，了解相关高管任命及相关权限；了解厦门联芯的组织架构及人员职责分工，授权情况；

（3）获取联华电子出具的关于发行人对厦门联芯具有实质控制权的确认函，以及联华电子对简山杰、林俊宏、王文杰、廖木良、陈进双、许志清、黄柏文尽职调查表或相关说明；

（4）获取厦门金圆、福建电子创业投资出具的关于发行人对厦门联芯具有实质控制权的确认函；

（5）获取厦门联芯财务、采购等部门负责人在和舰任职和领薪的资料等；

（6）对相关人员进行访谈，查阅了联华电子的年报。

### **2、核查结论**

经核查，申报会计师认为：在截止 2018 年 12 月 31 日联华电子对发行人持股比例为 98.14%、通过联华微芯对厦门联芯持股比例为 50.72%的背景下，发行人虽然持有厦门联芯股份比例不足 15%，但联华微芯表决权不可撤销地全权委托发行人行使，发行人能够控制厦门联芯的股东会；虽然厦门联芯董事主要为联华电子员工，但其由和舰芯片委派或者与发行人委派的董事采取了一致行动并以发行人委派的董事的意思表示为准。联华电子作出股东会表决权委托和在厦门联芯董事会采取一致行动，避免了管理团队重复建设，符合企业集团垂直管理商业实质，意思表示真实。发行人利益与联华电子根本利益一致，不会出现股东会表决权委托和在厦门联芯董事会采取一致行动失效情况出现，符合股东利益最大化原则。

和舰芯片自 2015 年 2 月以来从表决权上对厦门联芯一直具有控制权，通过委派董事和总经理、财务负责人等，控制董事会及经营管理团队，能够自主决定厦门联芯重大经营活动及财务决策。因此，和舰芯片对厦门联芯实质控制、纳入合并报表范围，依据充分，符合《企业会计准则》规定。

## 二、第二轮审核问询函 4. 关于厦门联芯回购条款

根据问询回复，厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权的回购由联华电子或通过其子公司联华微芯履行，回购方式为出资额加计固定收益，联华微芯、和舰有限、厦门金圆、福建电子创业投资四方于 2016 年 12 月 12 日签署的《合资合营合同》显示，回购义务由“联华微芯/发行人”完成。

请发行人说明：（1）上述股份回购事宜是厦门金圆、福建电子创业投资的权利还是义务，到期后能否选择继续持有；（2）在到期后以固定收益进行回购的情形下，不认定厦门金圆、福建电子创业投资所持厦门联芯股权属于“明股实债”的原因及合理性；（3）结合厦门联芯股份回购条款，说明在《合资合营合同》、《厦门联芯章程》未对盈亏承担予以具体约定的情况下，由四方股东按照比例进行分红或承担亏损是否符合“利益共享，风险共担”的原则，股东的权利和义务是否对等；（4）上述股份回购条款的约定是否经过了国资审批程序，是否可能会造成国有资产流失；（5）发行人及厦门联芯不承担回购义务是否经过厦门金圆及福建电子创业投资及其主管部门认可，若认可，请提供相关确认文件，若无相关认可，则发行人及厦门联芯是否确实不承担相关股份回购的义务；若发行人及厦门联芯需要承担相应回购义务，进一步说明相应会计处理情况，以及对发行人各期财务报表的具体影响。

请保荐机构、申报会计师对上述事项（5）进行核查，并发表明确意见。

回复：

(一) 发行人及厦门联芯不承担回购义务是否经过厦门金圆及福建电子创业投资及其主管部门认可，若认可，请提供相关确认文件，若无相关认可，则发行人及厦门联芯是否确实不承担相关股份回购的义务；若发行人及厦门联芯需要承担相应回购义务，进一步说明相应会计处理情况，以及对发行人各期财务报表的具体影响

申报会计师阅读了厦门市人民政府、联华电子、福建省电子集团于 2014 年签订的《参股协议书》，阅读了和舰有限、联华微芯、厦门金圆、福建电子集团四方于 2016 年 12 月签署的《合资合营合同》、《厦门联芯章程》，阅读了相关各方于 2018 年 7 月修订的《合资合营合同》、《厦门联芯章程》，并取得厦门金圆及福建电子创业投资出具的确认文件，经核查如下：

(1) 根据《合资合营合同》关于回购条款的相关规定，厦门联芯不是合同签署方、不承担回购义务。

(2) 根据《合资合营合同》约定，厦门金圆、福建电子集团出资的资本金，从其资本金到账后第 7 年开始，由发行人/联华微芯按 60%、20%、20%的比例分三次在连续三年完成全部回购。根据联华电子出具的确认文件，回购义务由联华电子及联华微芯承担，并取得了厦门金圆及福建电子创业投资的确认。

综上所述，发行人及厦门联芯不承担相关股份回购的义务。

## (二) 核查程序及核查结论

- 1、取得了厦门联芯的工商档案资料、登入“国家企业信用信息公示系统”对厦门金圆、福建电子创业投资工商登记信息予以查询；
- 2、取得厦门市人民政府、联华电子、福建省电子集团于 2014 年签订的《参股协议书》，核对相关内容；
- 3、取得厦门联芯《合资合营合同》、《章程》，核对回购条款及约定；
- 4、取得厦门金圆及福建电子创业投资关于回购义务出具的确认文件。

经核查，申报会计师认为：发行人及厦门联芯不承担相关股份回购的义务，并已经厦门金圆及福建电子创业投资确认，因此无需进一步进行相应会计处理，对发行人各期财务报表没有影响。

## 三、第二轮审核问询函 12. 关于制造费用

报告期内，12 英寸晶圆制造相关制造费用占主营业务成本的比例为 81%-88%，8 英寸晶圆制造相关制造费用占主营业务成本的比例为 51%-53%。发行人 12 英寸晶圆制造与 8 英寸晶圆制造费用占比差异较大。



请发行人说明制造费用按 12 英寸及 8 英寸项下的明细情况，包括但不限于制造费用的具体项目、内容、金额，归集及分摊的原则、是否符合《企业会计准则》的相关规定，报告期各期具体金额及变动的的原因，结合上述情况分析上述两种产品制造费用占比差异较大的原因。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

（一）请发行人说明制造费用按 12 英寸及 8 英寸项下的明细情况，包括但不限于制造费用的具体项目、内容、金额，报告期各期具体金额及变动的的原因

### 1、主营业务成本 12 英寸项下制造费用明细及变动情况分析

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
间接人工	21,332.67	18,484.90	2,509.74
水电瓦斯	19,847.48	17,252.48	1,127.00
折旧、摊销	269,898.24	178,498.90	9,549.89
机台维护、维修费	6,829.05	4,314.60	26.96
光罩	1,286.70	4,319.68	-
IP 授权费	932.84	1,465.41	-
其他	11,909.23	6,158.64	4,494.30
存货跌价准备及预计合同损失转回	-32,164.91	-16,685.08	-
合计	299,871.30	213,809.52	17,707.88
主营业务成本	338,057.00	247,871.48	21,800.16
占比	88.70%	86.26%	81.23%

报告期内厦门联芯（12 英寸）主营业务成本项下制造费用分别为 17,707.88 万元、213,809.52 万元、299,871.30 万元，制造费用不断增加，主要系厦门联芯自 2016 年 11 月正式开始量产，产销量逐年提高所致。12 英寸制造费用主要为折旧摊销费用、间接人工、水电燃气等。

2018 年度间接人工费用、折旧摊销费用、水电瓦斯费用、机台维护、维修费等费用较 2017 年度增加，系随着产能的增加也随之正常增加。光罩费用 2018 年度较 2017 年度减少，系光罩费用与客户定制的新产品型号直接相关，2017 年度新投入的产品型号较多而 2018 年度大部分产品系 2017 年已经开始生产所致。IP 授权费用 2018 年度较 2017 年度减少，系部分 IP 授权费用初费与新产品投入相关，第三方 IP 授权费用的变动也随着新产品的投入变动。2016 年度制造费用较低主要系正式量产期间较短所致。光罩、IP 授权费等为 0，系在试产过程已经开始使用，计入试产费用所致。

### 2、主营业务成本 8 英寸项下制造费用明细

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
间接人工	17,332.69	13,868.48	12,651.74
水电瓦斯	16,477.84	15,828.96	15,889.40
折旧、摊销	28,525.82	30,317.44	28,246.28
机台维护、维修费	7,873.53	6,590.44	5,534.68
光罩	42.03	7.22	7.65
IP 授权费	2,830.74	2,351.45	1,742.25
其他	5,270.48	3,319.98	3,492.98
合计	78,353.13	72,283.97	67,564.98
主营业务成本（已扣除内部交易抵消影响）	150,689.88	140,526.68	126,842.67
占比	52.00%	51.44%	53.27%

报告期内和舰芯片（8 英寸）主营业务成本项下制造费用分别为 67,564.98 万元、72,283.97 万元、78,353.13 万元，制造费用随产销量的增加有所增加。8 英寸制造费用主要为折旧摊销费用、间接人工、水电燃气等。

2018 年度间接人工增加金额较大，主要系和舰芯片公司因人才流失 2018 年度较大幅度的提高了工资薪酬水平，且间接人工主要为技术人员及生产管理人员，薪酬调整幅度相对较大。2018 年度折旧摊销费用略有下降，主要系 2018 年度部分机台设备折旧期满，不再计提折旧费用所致。和舰芯片光罩费用发生相对较低，主要系和舰芯片客户群体较为稳定，新产品投入品种较少，且 8 英寸芯片光罩费用制作成本较 12 英寸光罩费用较低所致。

## （二）制造费用归集及分摊原则，是否符合《企业会计准则》的相关规定

发行人采用大型 ERP 系统核算、归集、分摊制造相关成本，制造费用采用标准成本法归集、分摊至产品成本。发行人每季度根据上季度实际发生的制造费用为基础，将发生的制造费用分配至每一制造环节，制定每一制造环节的标准成本。每一制造环节的固定资产折旧费用等固定标准成本根据该制造环节的实际资产折旧额等为基础，人工及其他制造费用根据该制造环节的标准工时为基础制定。由于晶圆生产的特殊性，产品生产系按照晶体层、金属层逐层生产，因此产品在制造环节循环往复，根据产品累计经历的制造环节按照标准成本归集产品成本，直至产品完工。月末将实际发生的制造费用与标准成本中的制造费用的差异分配至每一生产环节，进而汇总累计经历的制造环节制造费用差异分配至产品成本，包括在产品及产成品。标准成本每季度根据上季度实际耗用情况进行调整。

发行人制造费用核算根据 ERP 自动计算，产品完工累计经历的制造环节几百次，每一制造环节的标准成本制定考虑了设备机台的折旧差异和其他特殊差异等，成本核算较为精细，制造费用归集完整、分配方法合理，符合《会计准则》的相关规定。

### （三）12 英寸及 8 英寸两种产品制造费用占比差异较大的原因

报告期内，12 英寸晶圆制造相关制造费用占主营业务成本的比例为 81%-88%，8 英寸晶圆制造相关制造费用占主营业务成本的比例为 51%-53%，差异较大的原因主要由 12 英寸及 8 英寸折旧摊销费用占主营业务成本的差异较多所致。具体来说，报告期内 12 英寸折旧摊销费用占主营业务成本的比例分别为 43.81%、72.01%、79.84%，8 英寸折旧摊销费用占主营业务成本的比例分别为 22.27%、21.57%、18.93%，原因系厦门联芯建设投产购置设备和无形资产金额较大，导致计入制造费用的折旧摊销费用金额较大。

### （四）核查程序及核查结论

- 1、对发行人生产制造部门、财务部门进行访谈，并实地查看生产过程；
- 2、取得发行人与生产制造相关的内控制度，对生产相关的内部控制执行的有效性进行验证；
- 3、取得制造费用明细，对主要项目进行审核，对折旧、摊销、间接人工等费用进行勾稽核对，对其他制造费用发生的真实性进行抽样测试；
- 4、抽取资产负债表日前后制造费用样本，对制造费用的截止是否正确进行验证；
- 5、抽取样本对产品成本的归集分配情况进行测试，对成本核算方法是否合理、成本核算是否一致进行验证。

经核查，申报会计师认为：（1）发行人制造费用主要为折旧摊销费用、间接人工、水电燃气等；（2）制造费用归集、分摊原则符合《企业会计准则》的相关规定；（3）12 英寸及 8 英寸制造费用占比差异较大主要由于折旧摊销费用占主营业务成本的差异较大所致，符合发行人实际经营情况。

## 四、第二轮审核问询函 13. 关于销售费用

发行人销售费用中样品费变化较大，2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司样品费分别为 658.27 万元、3,845.38 万元、4,702.19 万元。请发行人说明报告期样品费用大幅增长的原因、确认依据、提供的对象名称、具体样品型号、提供时点、已经产生收入的时点、金额，报告期各类产品对应样品提供时点、产生收入时点，结合上述情况分析样品费用的变动对报告期及未来经营业绩的影响。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

### （一）报告期样品费用大幅增长的原因

单位：万元

单位	2018 年度	2017 年度	2016 年度
和舰芯片	554.90	599.96	419.66
厦门联芯	4,147.29	3,245.42	238.61
合计	4,702.19	3,845.38	658.27

报告期内，发行人样品费用金额分别为 658.27 万元、3,845.38 万元、4,702.19 万元，样品费用不断增加。其中母公司的样品费用分别为 419.66 万元、599.96 万元、554.90 万元，变动不大；厦门联芯样品费用分别为 238.61 万元、3,245.42 万元、4,147.29 万元，主要系自 2016 年 11 月正式量产，随着销量的增加，对于开发的新客户和提供新的产品型号，需要提供样品量随之增加。

**（二）请发行人说明报告期样品费用确认依据、提供的对象名称、具体样品型号、提供时点、已经产生收入的时点、金额，报告期各类产品对应样品提供时点、产生收入时点**

发行人样品系为开发客户或承接原有客户新产品试制样品，并免费向客户提供供客户测试验证使用。样品费系生产归集样品产品成本在样品发出后直接转入当期销售费用。

**1、和舰芯片样品费用提供的对象名称、具体样品型号、提供时点、已经产生收入的时点**

**（1）2018 年度**

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
矽力杰	H11959-P0	2018/1/15	0.98	2018/3/19	243.18
联咏	H11933FS	2018/1/10	0.62	2018/3/6	7,440.72
苏州日月成科技有限公司	H11978FS	2018/1/2	0.32	2018/2/26	470.19
矽力杰	H11959-P0	2018/1/17	2.94	2018/3/19	243.18
矽力杰	H11959-P0	2018/1/15	3.75	2018/3/19	243.18
联咏	H11933FS	2018/1/15	0.41	2018/3/6	7,440.72
矽力杰	H11959-P0	2018/2/2	4.09	2018/3/19	243.18
钰泉光电科技（上海）股份有限公司	H12029FS	2018/2/14	0.28	2018/3/19	605.10
联咏	H11933FS	2018/2/6	5.14	2018/3/6	7,440.72
珠海格力电器股份有限公司	H11913FS	2018/2/1	0.63	2018/11/16	850.94
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计			554.90		81,109.75

**（2）2017 年度**

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
联咏	H11715FS	2017/1/3	0.50	2017/5/9	3,196.38
瑞鼎科技股份有限公司	H11783FS	2017/1/9	1.13	2017/3/2	1,560.53

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
苏州迈瑞微电子有限公司	H11857	2017/1/10	0.71	2017/4/25	244.24
盛群半导体	H11606FS	2017/1/11	1.31	2017/8/1	445.10
瑞鼎科技股份有限公司	H11783FS	2017/1/3	2.65	2017/3/2	1,560.53
扬智科技股份有限公司	H11841FS	2017/1/3	5.80	2017/11/8	1,118.81
原相科技	H11701FS	2017/2/4	0.40	2017/8/2	74.95
扬智科技股份有限公司	H11841FS	2017/4/24	0.46	2017/11/8	1,118.81
扬智科技股份有限公司	H11841FS	2017/4/24	1.37	2017/11/8	1,118.81
奇景光电股份有限公司	H11926FS	2017/4/18	0.89	2017/11/17	1,086.65
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计			599.96		68,812.26

**(3) 2016年度**

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
联咏	H11191FS	2016/1/13	0.18	2016/11/23	6,639.18
联咏	H11412FS	2016/1/14	0.79	2016/2/16	20,538.04
联咏	H11412FS	2016/1/19	2.10	2016/2/16	20,538.04
联咏	H11412FS	2016/1/19	0.79	2016/2/16	20,538.04
珠海艾派克微电子有限公司	H11251FS	2016/1/28	0.85	2016/6/2	588.39
联咏	H11412FS	2016/1/20	0.53	2016/2/16	20,538.04
联咏	H11707FS	2016/1/19	0.46	2016/9/20	1,290.85
联咏	H11707FS	2016/1/19	0.46	2016/9/20	1,290.85
联咏	H11412FS	2016/1/4	0.53	2016/2/16	20,538.04
联咏	H11707FS	2016/1/6	0.46	2016/9/20	1,290.85
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计			419.66		43,045.58

**2、厦门联芯样品费用提供的对象名称、具体样品型号、提供时点、已经产生收入的时点**
**(1) 2018年度**

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
联发科	F020	2018/01/02	38.59	2018/05/04	33,338.58
展讯通信（上海）有限公司	AK40	2018/01/27	9.21	2018/03/09	9,137.44
展讯通信（上海）有限公司	AK40	2018/01/27	9.21	2018/03/09	9,137.44
展讯通信（上海）有限公司	AK40	2018/01/27	15.35	2018/03/09	9,137.44
联发科	F020	2018/01/31	35.62	2018/05/04	33,338.58
美国联电	A912T-AT	2018/01/02	24.84	未上量	-
联发科	F020	2018/01/02	29.68	2018/05/04	33,338.58

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
美国联电	A912T-AT	2018/01/17	40.36	未上量	-
联发科	F020	2018/01/02	38.59	2018/05/04	33,338.58
美国联电	AF90	2018/01/26	6.91	2018/02/26	13,711.73
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计			4,147.29		98,997.41

## (2) 2017 年度

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
美国联电	AF90	2017/01/23	6.59	2018/02/26	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2017/01/05	3.20	2017/10/09	19,322.59
福州瑞芯微电子股份有限公司	AJ48	2017/01/04	6.21	未上量	-
群联电子股份有限公司	R761	2017/01/18	6.91	未上量	-
美国联电	AF90	2017/01/14	9.88	2018/02/26	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2017/01/14	3.20	2017/10/09	19,322.59
美国联电	AF90	2017/01/14	9.88	2018/02/26	-
群联电子股份有限公司	R761	2017/01/18	10.37	未上量	-
联发科	F002	2017/01/19	76.32	2017/06/09	17,456.50
美国联电	AF90	2017/01/14	32.94	2018/02/26	-
.....	.....	.....	.....	.....	.....
合计			3,245.42		63,227.48

## (3) 2016 年度

单位：万元

客户名称	样品型号	提供时点	样品金额	对应量产收入时点	当期实现销售收入
联发科	F002	2016/11/12	41.56	2017/06/09	-
联发科	F002	2016/11/02	6.39	2017/06/09	-
联发科	F002	2016/11/16	19.18	2017/06/09	-
联发科	AJ62	2016/11/03	6.97	未上量	-
联发科	F002	2016/12/07	14.71	2017/06/09	-
联发科	F002	2016/12/07	11.03	2017/06/09	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2016/12/28	7.67	2017/10/09	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2016/12/28	11.51	2017/10/09	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2016/12/27	7.67	2017/10/09	-
联发科	F002	2016/12/01	22.07	2017/06/09	-
联发科	F002	2016/12/01	14.71	2017/06/09	-
展讯通信（上海）有限公司	AK00	2016/12/29	38.35	2017/10/09	-
联发科	F002	2016/12/07	36.78	2017/06/09	-
合计			238.61		

### （三）分析样品费用的变动对报告期及未来经营业绩的影响

报告期样品费用与对应型号的当期订单收入比例存在一定比例关系，报告期和舰芯片样品费用占对应型号订单收入比例为：

单位：万元

单位	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
和舰芯片	样品费用	554.90	599.96	419.66
	当期对应型号订单收入	81,109.75	68,812.26	43,045.58
	占比	0.68%	0.87%	0.97%
厦门联芯	样品费用	4,147.29	3,245.42	238.61
	当期对应型号订单收入	98,997.41	63,227.48	-
	占比	4.19%	5.13%	-

和舰芯片样品费占比基本稳定，对应实现的订单收入逐年增加，与和舰芯片收入整体匹配；厦门联芯样品费占比也基本稳定，对应实现的订单收入逐年增加，与厦门联芯产能扩展，收入逐年增加整体匹配。厦门联芯样品费占比较和舰芯片样品费占比高出 6 倍左右，一方面因 12 寸晶圆因设备投入巨大，折旧摊销成本较高，导致样品生产成本较高，另一方面系厦门联芯为新设公司，新开发客户数量和产品型号不断增加，导致产品验证的样品费较高所致。

总体而言，样品费的增加与未来收入增加有匹配关系，但如报告期内样品费用发生与销售收入对应关系具体明细分析所示，单家样品费用发生额与未来订单金额无明确固定关系，样品费用发生时间与量产订单时间在 1-10 月之间，个别客户因生产过程中工艺流程改变或设计改变也需重新提供样品测试，对应的量产订单时间反而早于样品提供时间，也不存在固定时间关系。

### （四）核查程序及核查结论

- 1、了解销售业务中与样品相关的内控并测试评价其内部控制执行的有效性；
- 2、抽样检查样品发出相关凭证，包括样品生产订单、出库单、样品快递记录等，证实样品费用记录真实、完整；
- 3、检查报表截止日前后样品发出记录，以证实样品费用记录截止正确；
- 4、抽样检查样品费与销售订单对应明细，以证实样品费与量产收入对应表编制真实无误。

经核查，申报会计师认为：发行人报告期样品费用变化较大，主要系厦门联芯公司系新设公司自 2016 年 11 月正式量产，开发的新客户和提供新的产品型号增加导致需要提供样品量随之增加所致；报告期样品费占对应型号订单收入比例较为稳定，样品费用的增加与未来收入增加有一定的匹配关系。

## 五、第二轮审核问询函 14. 关于管理费用

2016 年度公司管理费用占营业收入的比例为 26.65%，占比较高，主要原因为厦门联芯 2016 年开始生产，前期试生产、工艺调试等大额支出计入管理费用所致。请发行人说明前期试生产、工艺调试等大额支出的具体内容、金额、确认时点及依据、与固定资产转固时点是否匹配，结合前期生产经营说明试生产、工艺调整等大额支出是否处于合理水平，并分析预计未来在建工程转固前试生产、工艺调试等大额支出对经营业绩的影响。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

### （一）前期试生产、工艺调试等大额支出的具体内容、金额、确认时点及依据、与固定资产转固时点是否匹配

厦门联芯公司于 2016 年 4 月完成洁净室建设、第一批生产机台设备安装完毕，进入联机测试阶段，以展讯通讯上海有限公司订单为测试量产产品。经过大规模生产测试、工艺调试，9 月份完成小批量样品交货，10 月正式完成大批量产品订单试生产。产品良品率达到客户合同约定的良品率以上，10 月末完成产品交付。除部分产品质量检测等设备完成安装测试后直接转固，其他第一批机台设备于 2016 年 10 月大规模工艺调试完成后转入固定资产，并于 11 月开始计提累计折旧。

前期机台设备联机测试、工艺调试等费用明细如下：

单位：万元

项目	金额
人工相关费用	8,989.27
水电、运杂费	7,247.78
直接材料耗用	17,031.32
机台维护、修理费	4,268.57
其他费用	561.80
试产产品收入	-1,315.18
合计	36,783.55

根据企业会计准则相关规定，工程达到预定可使用状态前因进行负荷联合试车所发生的净支出，计入工程成本。企业的在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的负荷联合试车过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按其实际销售收入或预计售价冲减工程成本。



由于晶圆制造企业特殊性，12寸晶圆制造在正常情况下产品生产周期也需要1-3月，厦门联芯公司因联机测试、工艺流程调试，生产周期达到6个月，将试产费用计入在建工程并不合理，厦门联芯公司将机台首次联机测试及工艺流程调试等支出计入当期损益，测试产生的产品收入冲减测试费用。

综上，公司前期试生产、工艺调试等大额支出主要为直接材料耗用、人工相关费用、水电运杂费、机台维护修理费等；公司第一批机台设备主要于2016年10月转入固定资产，试生产、工艺调试等大额支出与固定资产转固时点匹配。

### **（二）结合前期生产经营说明试生产、工艺调整等大额支出是否处于合理水平，并分析预计未来在建工程转固前试生产、工艺调试等大额支出对经营业绩的影响**

2016年度发生大额试生产、工艺流程调试费用，系厦门联芯生产线首次建设完毕的大规模测试费用，由于测试周期相对较长，耗用的材料、人工、费用金额相对较大因此相关成本耗用金额偏大，符合产线首次建设试产的实际情况。

厦门联芯产品均为自动化生产，前期试生产、工艺流程调整主要工作在于调整机台控制软件系统的正常工作，自动化产线流程控制系统的编程调整、联机调试，前期自动化产线、机台设备的运行故障分析及解决等。而后续机台安装测试，系在原产线上增补机台设备，随着新增机台的测试合格纳入产线转入固定资产，后续机台的安装调试工作相对较少，因此未来不会大规模发生在在建工程试生产、工艺调试等大额支出。厦门联芯公司于2017年至2018年陆续转固大量固定资产，未再大规模发生试产相关费用。

### **（三）核查程序及核查结论**

- 1、了解固定资产相关的内控并测试评价其内部控制执行的有效性；
- 2、对管理费用进行细节测试，抽样检查试生产、工艺调试相关费用原始凭证，以证实相关费用发生真实、完整；
- 3、对固定资产进行监盘，获取固定资产折旧明细表，检查固定资产达到可使用状态的时点是否适当，检查待检验设备及在建工程尚未达到使用状态是否真实合理。

经核查，申报会计师认为：（1）公司前期试生产、工艺调试等大额支出主要为直接材料耗用、人工相关费用、水电运杂费、机台维护修理费等；试生产、工艺调试等大额支出与固定资产转固时点匹配；（2）公司试生产、工艺调整等大额支出处于合理水平，预计未来不会发生在在建工程转固前试生产、工艺调试等大额支出。

## 六、第二轮审核问询函 15. 关于研发支出

根据申报材料及问询回复，发行人报告期内研发支出中的材料支出主要是其他材料支出，报告期内各期其他材料支出分别为 8,402.22 万元、10,961.68 万元、11,953.06 万元，占材料支出比重分别为 70.31%、62.62%、59.37%，材料最终去向主要是研发测试后报废。

请发行人说明：（1）其他材料的主要内容，是否与研发活动直接相关；（2）材料研发测试后报废后具体处理方式，涉及销售相关废品的，说明各期相关废品销售收入情况，涉及支付费用请第三方处理相关废品的，说明各期处理数量及处理费用金额。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

### （一）其他材料的主要内容，是否与研发活动直接相关

会计师对第一次审核问询函二、7 回复时，描述的主要材料 3 为其他材料，描述不准确。实际发行人研发费用中材料费用包括研发测试用产品生产使用的光罩、原材料、人工、生产机台折旧、研发产品检测费用等，在第一次问询函将主要材料光罩、晶圆单独列示后，剩余部分包括其他材料和制造、检测相关费用。本次答复更正为“其他材料及费用”。

其他材料及费用主要系研发测试用产品在试制过程中耗用的化学品（气体、光阻等）消耗性材料、针测板、挡控片等原材料及生产过程中分摊的生产设备折旧摊销、人工费、检测费等。具体情况如下：

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
研发测试产品生产耗用人工	67.05	92.10	48.49
研发测试产品生产耗用机台折旧	9,627.79	10,145.40	6,038.26
研发测试产品检测费	1,906.63	346.60	2,026.80
化学品-气体	15.02	12.06	9.57
消耗材料	69.66	16.43	114.29
档控片	96.97	132.93	41.97
针测板	163.74	192.71	110.35
其他原材料	6.19	23.45	12.50
合计	11,953.06	10,961.68	8,402.22

由于与产品生产过程一样，研发产品在生产过程中也在生产所用的机台设备上加工生产，研发产品耗用的材料除光罩、硅片外，其他材料包括化学品（气体、光阻等）消耗性材料等原材料在不

同的机台设备上持续供应，同时耗用机台折旧、人工等，因此与产品成本归集核算一致，采用标准成本为基础归集核算研发产品在不同生产环节耗用材料、费用等。研发产品耗用的针测板、挡控片及发生的检测费根据实际领用或者实际发生计入研发费用。故研发产品生产耗用的其他材料、人工、折旧及检测费等，均与研发活动直接相关。

**（二）材料研发测试后报废后具体处理方式，涉及销售相关废品的，说明各期相关废品销售收入情况，涉及支付费用请第三方处理相关废品的，说明各期处理数量及处理费用金额**

报告期发行人发生的研发晶圆报废数量及处理费用情况如下：

单位：万元

主体	项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
和舰芯片	研发报废产品废品收入	-	-	-
	研发产品报废处理数量（片数）	2,769	3,810	3,404
	研发产品报废处理数量（公斤）	145.74	200.53	179.16
	报废处理费	-	-	-
厦门联芯	研发报废产品废品收入	-	-	-
	研发产品报废处理数量（片数）	3,411	2,692	1,334
	研发产品报废处理数量（公斤）	426.42	336.54	166.79
	报废处理费（含不良品报废处理费）	1.04	5.27	-

研发生产的晶圆（晶粒），系研发测试目的使用，而客户产品均为其定制，具体参数、性能等均不一致，因此发行人研发所形成产品无法对外销售，在完成相关研发测试目的后，发行人与生产中产生的残次产品一同进行报废处理。因研发及量产产品不良品均为晶圆，采用物理性压碎、磨粉处理即完成产品报废，压碎后产生的固体废弃物，委托第三方进行处理。

磨粉后的晶圆报废形成固体废弃物，可回收利用，和舰芯片委托苏州市昌兴再生物资回收有限公司处理，不收取废弃物出售款也无需支付处理费用；厦门联芯公司委托厦门三元鑫环保科技有限公司处理，需支付少量处理费用。

### （三）核查程序及核查结论

- 1、获取发行人分项目归集的研发费用明细表，检查研发项目的立项文件、开发计划、费用预算、研发成果报告等相关文件；
- 2、检查研发费用归集明细，检查其原始凭证是否真实，会计处理是否正确；
- 3、对研发费用实施截止日测试，检查是否存在跨期入账情况；
- 4、了解研发样品报废处理流程，检查产品报废处理记录是否真实；

5、检查废品处理相关凭证，废料出厂记录，证实处理费用真实、完整。

经核查，申报会计师认为：（1）其他材料主要系研发测试用产品在试制过程中耗用的化学品（气体、光阻等）消耗性材料、针测板、挡控片等原材料及生产过程中分摊的生产设备折旧摊销、人工费、检测费等，均与研发活动直接相关；（2）材料研发测试经压碎后报废，产生的固体废弃物委托第三方进行处理，相关废品未产生销售收入，相关处理费用金额较小。

#### 七、第二轮审核问询函 16. 关于固定资产转固时点

报告期内各期，公司 12 英寸晶圆制造业务的毛利率分别为-170.20%、-125.28%和-156.96%，毛利率为负的原因为厦门联芯建设投产购置设备和无形资产金额较大，导致投产前期固定成本分摊较大，造成营业成本大于营业收入引起。

请发行人补充披露：（1）厦门联芯报告期各期固定资产转固时点、金额、转固条件是否符合《企业会计准则》的相关规定，并预计截止 2018 年末各类在建工程转固时间，分析对未来期间经营业绩的影响；（2）报告期各期借款利息支出的具体构成，以及分别计入财务费用及资本化的情况。

请保荐机构、申报会计师对上述事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

（一）厦门联芯报告期各期固定资产转固时点、金额、转固条件是否符合《企业会计准则》的相关规定

#### 1、2018 年度固定资产转固情况

单位：万元

转固时点	转固金额				
	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1 月	135.92	66,786.69	70.11	380.89	67,373.60
2 月	50.01	78,117.88	-	14.45	78,182.34
3 月	-	11,039.65	-	1,341.67	12,381.32
4 月	-	34,816.43	-	55.39	34,871.81
5 月	522.50	59,234.65	-	162.61	59,919.75
6 月	1,950.27	50,028.09	-	2.90	51,981.26
7 月	-	13,573.18	-	2.14	13,575.31
8 月	153.99	6,558.24	-	547.78	7,260.02
9 月	-	14,388.58	-	16.74	14,405.32
10 月	-	9,960.26	-	1.62	9,961.87
11 月	-	2,205.76	-	9.62	2,215.37

转固时点	转固金额				
	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
12月	-	7,639.93	-	-	7,639.93
合计	2,812.69	354,349.32	70.11	2,535.79	359,767.92

## 2、2017年度固定资产转固情况

单位：万元

转固时点	转固金额				
	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
1月	2,466.00	36,939.12	-	186.76	39,591.88
2月	-	2,677.53	-	619.28	3,296.81
3月	48.41	57,074.47	-	5,958.66	63,081.55
4月	-	81,153.23	-	499.70	81,652.94
5月	6,632.75	98,270.73	-	7.63	104,911.11
6月	9,832.60	177,690.52	10.09	1,458.74	188,991.94
7月	40.48	45,288.60	-	60.72	45,389.80
8月	2,200.00	17,774.51	-	3,685.57	23,660.08
9月	-	25,122.22	-	-	25,122.22
10月	56.67	23,393.78	-	34.05	23,484.50
11月	6,618.62	9,197.43	-	28.37	15,844.42
12月	866.41	30,242.32	-	25.79	31,134.52
合计	28,761.95	604,824.46	10.09	12,565.26	646,161.75

## 3、2016年度固定资产转固情况

单位：万元

转固时点	转固金额				
	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
5月	-	2,505.32	-	-	2,505.32
6月	-	51.54	-	-	51.54
9月	-	3,341.46	-	-	3,341.46
10月	97,920.63	506,689.31	106.88	1,732.78	606,449.60
11月	6,686.58	51,201.70	-	441.91	58,330.18
12月	342.93	65,654.97	-	977.98	66,975.88
合计	104,950.13	629,444.30	106.88	3,152.67	737,653.98

固定资产转固时点系根据各项资产达到预定使用状态为标准进行转固，其中不需要联机测试的固定资产在资产安装完毕基本功能测试检验合格转入固定资产，需要联机测试的待联机测试生产合格产品后转入固定资产。发行人对于固定资产的转固时点判断符合企业的实际经营特点，符合《企业会计准则》的相关规定。

## （二）预计截止 2018 年末各类在建工程转固时间，分析对未来期间经营业绩的影响

截止 2018 年 12 月 31 日，厦门联芯公司各类在建工程预计转固时间、预计新增折旧费用如下：

单位：万元

预计在建工程转入固定资产	转入固定资产金额			预计 2019 年增加的折旧费用
	机器设备	办公设备	合计	
2019 年 1 月实际转固	13,184.35	88.34	13,272.69	2,041.27
2019 年 2 月实际转固	7,051.16	-	7,051.16	979.33
2019 年 3 月实际转固	1,091.38	-	1,091.38	136.42
2019 年 4 月实际转固	779.21	-	779.21	86.58
预计 2019 年 5 月转固	8,848.92	30.24	8,879.15	866.19
预计 2019 年 6 月转固	6,637.09	-	6,637.09	553.09
预计 2019 年 7 月转固	3,448.70	-	3,448.70	239.49
预计 2019 年 8 月转固	3,314.37	-	3,314.37	184.13
预计 2019 年 9 月转固	1,104.89	-	1,104.89	46.04
预计 2019 年 10 月转固	-	-	-	-
预计 2019 年 11 月转固	-	-	-	-
预计 2019 年 12 月转固	9,901.34	-	9,901.34	-
合计	55,361.42	118.58	55,480.00	5,132.54

厦门联芯 2018 年末在建工程逐步转固后，2019 年度将新增约 5,132.54 万元折旧费用，预计在资产使用寿命内以后每年将增加约 9,246.67 万元折旧费用。

## （三）报告期各期借款利息支出的具体构成，以及分别计入财务费用及资本化的情况

厦门联芯报告期各期借款利息支出的具体构成如下：

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	2016 年
银行短期借款利息支出	3,911.75	4,088.92	5,114.54
银行长期借款利息支出	20,804.54	24,222.10	3,896.16
外债借款利息支出	1,882.31	647.19	-
合计	26,598.60	28,958.20	9,010.70

注：外债借款系厦门联芯公司向联华电子公司、新加坡分公司借款

报告期各期，发行人借款利息支出不存在利息资本化情形，均计入财务费用-利息支出。

## （四）核查程序及核查结论

1、了解固定资产采购及后续计量的内控设计并测试评价其内部控制执行的有效性；

2、执行固定资产、在建工程的监盘程序，检查固定资产在建工程的存在性及实际使用状况，以及在建工程的进度；

3、执行固定资产采购测试程序，选取样本检查固定资产立项、合同（订单）、进口报关、发票、运输单据、验收（固定资产入库单）、付款等支持性单据；

4、检查固定资产达到可使用状态的时点是否适当，检查待检验设备及在建工程尚未达到使用状态是否真实合理；

经核查，申报会计师认为：（1）厦门联芯报告期各期固定资产转固时点、转固条件符合《企业会计准则》的相关规定；（2）厦门联芯 2018 年末在建工程转固后，2019 年度将新增约 5,132.54 万元折旧费用，预计在资产使用寿命内以后每年将增加约 9,246.67 万元折旧费用；（3）报告期各期借款利息支出的全部计入财务费用，不存在资本化的情况。

#### 八、第二轮审核问询函 17. 关于政府无息贷款

招股说明书披露“根据财政部《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》财税[2011]107 号文件的规定，厦门联芯属于国家批准的集成电路重大项目企业，享受购进设备形成的增值税期末留抵税额准予退还的增值税优惠政策。”经查询厦门联芯未在财税[2011]107 号文件所附的企业名单中。问询回复显示，发行人取得的政府无息借款具体还款条件等也涉及厦门联芯未来取得相关留抵税额的返还。

请保荐机构及申报会计师核查以下事项并发表明确意见：（1）厦门联芯是否依据财税[2011]107 号文件取得相关税收优惠，若不符合相关规定，是否影响后续取得相关增值税期末留抵税额退还；（2）若无法取得增值税期末留抵税额退还，对相关政府无息借款的取得与归还等的具体影响。

回复：

（一）厦门联芯是否依据财税[2011]107 号文件取得相关税收优惠，若不符合相关规定，是否影响后续取得相关增值税期末留抵税额退还

为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）有关要求，解决集成电路重大项目企业采购设备引起的增值税进项税额占用资金问题，财政部、国税总局发布了《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》财税[2011]107 号，制定了退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额具体的政策并公布了第一批适用该项政策国家批准的集成电路重大项目企业名单。

厦门联芯公司系财政部、国家税务总局《关于发布第三批适用退还增值税期末留抵税额政策的集成电路重大项目企业名单的通知》财税[2017]5 号列示的第三批国家批准的集成电路重大项目企业。依据财税[2011]107 号文件的具体政策而取得相关税收优惠符合国家政策的规定，不会影响后续取得相关增值税期末留抵额的退还。

### **(二) 若无法取得增值税期末留抵税额退还，对相关政府无息借款的取得与归还等的具体影响**

基于厦门联芯公司系财政部、国家税务总局批准享受增值税期末留抵额退还的集成电路重大项目企业，享有法定增值税期末留抵税额退还权利。在尚未取得国家退还增值税留抵额的情况下，与政府签订的无息借款合同继续有效，如果期后取得增值税留抵额退还，厦门联芯公司将立即归还政府无息借款。

### **(三) 核查程序及核查结论**

- 1、取得并查询相关税收优惠政策，核实发行人是否属于税收优惠政策规定的范围；
- 2、取得厦门联芯纳税申报表，核对纳税申报数据是否属实、与账载数据是否一致；
- 3、抽样检查进销项记录，与原始采购单据包括增值税专用发票、海关进口增值税缴款是否一致；
- 4、取得厦门联芯与火炬管委会签订的借款合同，核对相关合同条款，判断合同的执行有效性。

经核查，申报会计师认为：（1）厦门联芯公司系财政部、国家税务总局《关于发布第三批适用退还增值税期末留抵税额政策的集成电路重大项目企业名单的通知》（财税[2017]5 号）列示的第三批国家批准的集成电路重大项目企业，因此依据财税[2011]107 号及财税[2017]5 号文件取得相关税收优惠，符合相关规定；（2）厦门联芯享有法定增值税期末留抵税额退还权利，不存在无法取得增值税期末留抵额退还风险。

## **九、第二轮审核问询函 18. 其他**

请发行人说明：（1）对原材料计提提高比例存货跌价准备的商业合理性；（2）政府补助对报告期内业绩及经营活动现金净流量的具体影响，以及报告期后是否能持续获得相同规模的政府补助；（3）对部分应收账款组合采用余额百分比法计提坏账准备的原因，以及报告期各期末涉及的金额、账龄情况、采用余额百分比法计提坏账的依据、相关坏账准备计提的比例及充分性。

问询回复及招股说明书存在的错误或矛盾表述，请发行人相应修改，包括但不限于：（1）招股说明书通过列表形式披露公司已经履行完毕的、正在履行的金额 5,000 万元以上的重大借款合同，表格中对于借款方的描述为借款银行，而其中厦门火炬高技术产业开发区管理委员会并非银行；（2）问询回复问题第 42 中，发行人回复报告期内变更了部分会计政策及核算方法，但在保荐机构及申报



会计师核查意见中认定，除了《企业会计准则》发布及法规变化要求以外，报告期内不存在会计政策变更或会计估计变更的情况。

请保荐机构、申报会计师对以上事项进行核查，并发表明确意见。

回复：

**（一）对原材料计提提高比例存货跌价准备的商业合理性**

根据《企业会计准则——存货》相关规定：“资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。企业确定存货的可变现净值，应当以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。”

对于持有目的为待转销的原材料的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额。而厦门联芯持有的原材料目的均为向目标客户按照订单等交付产品，故原材料的可变现净值为产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

厦门联芯因其为新设公司，后续加工成本因折旧摊销等因素导致偏高，导致存货的可变现净值低于存货成本或者可变现净值为负数，因此根据企业会计准则的规定，需要在资产负债表日计提存货跌价准备。厦门联芯的原材料持有的商业目的均为生产加工后交付客户产品，按照企业会计准则的规定计提提高比例的存货跌价准备具有商业合理性。

由于厦门联芯公司折旧、摊销等因素持续影响存货的加工成本，依企业会计准则的规定未来仍然需要对原材料计提提高比例的存货跌价准备。

**（二）政府补助对报告期内业绩及经营活动现金净流量的具体影响，以及报告期后是否能持续获得相同规模的政府补助**

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到的政府补助的现金流量	175,801.72	207,712.43	137,790.35
经营活动现金净流量	320,550.51	291,321.95	126,710.16
占比	54.84%	71.30%	108.74%
计入当期损益的政府补助（扣除所得税影响）	104,658.23	34,370.87	3,399.90
净利润	-260,188.96	-126,678.46	-114,938.96
占比	-40.22%	-27.13%	-2.96%
计入归属于母公司净利润的政府补助（扣除所得税影响）	16,516.44	7,498.31	1,174.05

项目	2018 年度	2017 年度	2016 年度
归属于母公司净利润	2,992.72	7,128.79	-14,390.50
占比	551.89%	105.18%	-8.16%

报告期内，公司收到的政府补助分别为 137,790.35 万元、207,712.43 万元、175,801.72 万元，占经营活动现金流量净额的比例分别为 108.74%、71.30%、54.84%，占比较高但报告期内逐年下降。报告期内，公司计入当期损益的政府补助（扣除所得税影响）分别为 3,399.90 万元、34,370.87 万元、104,658.23 万元，占当期净利润的比例分别为-2.96%、-27.13%、-40.22%。

未来政府补助现金流入具有较大的不确定性。报告期政府补助现金流对经营活动现金净流量的占比逐年降低，且随着厦门联芯的产能逐步扩充，政府补助现金流对经营活动现金净流量的影响将会进一步降低。

报告期发行人取得的政府补助多数为与资产相关的政府补助，将在资产使用寿命内平均计入当年损益，在未来几年内政府补助计入当期损益的金额较为稳定。

**（三）对部分应收账款组合采用余额百分比法计提坏账准备的原因，以及报告期各期末涉及的金额、账龄情况、采用余额百分比法计提坏账的依据、相关坏账准备计提的比例及充分性。**

报告期采用余额百分比法计提坏账准备的组合如下：

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
上市申报中介机构服务费	不适用	0.00
纳入合并范围的关联方组合	0.00	0.00
员工暂支备用金、保证金及押金	不适用	5.00

纳入合并范围的关联方欠款，已在合并报表编制过程中抵消，合并报表中无应收合并范围内各子公司款项，不涉及计提坏账准备。

采用余额百分比法计提坏账准备的组合系员工暂支备用金、保证金及押金和上市申报中介机构服务费，报告期采用余额百分比法计提坏账准备的组合的余额、账龄情况如下：

单位：万元

项目	2018 年余额	坏账准备	账龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
押金、保证金	264.76	13.24	206.95	-	7.20	50.61
备用金	38.15	1.91	38.15	-	-	-
上市申报中介机构服务费	726.42	-	726.42	-	-	-
合计	1,029.32	15.15	971.51	-	7.20	50.61

单位：万元

项目	2017 年余额	坏账准备	账龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
押金、保证金	496.13	24.81	1.52	26.08	384.20	84.34
备用金	34.80	1.74	34.80	-	-	-
上市申报中介机构服务费	-	-	-	-	-	-
合计	530.93	26.55	36.32	26.08	384.20	84.34

单位：万元

项目	2016 年余额	坏账准备	账龄			
			1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
押金、保证金	2,698.53	134.93	27.08	2,587.12	2.60	81.74
备用金	47.76	2.39	47.76	-	-	-
上市申报中介机构服务费	-	-	-	-	-	-
合计	2,746.29	137.31	74.84	2,587.12	2.60	81.74

对员工暂支备用金采用余额百分比法计提坏账准备的原因系，发行人员工备用金系经常性往来，发行人有完善的备用金管理制度，且可以有多重手段保证备用金的可收回性。

对保证金及押金采用余额百分比法计提坏账准备的原因系，主要系供应商收取的保证金及押金或海关等政府部门收取的押金，根据法律规定发行人欠付的货款与供应商收取的保证金、押金等拥有法定抵销权，可以保证债权的实现；政府部门收取的押金风险不可收回的风险极低，若因发行人因违反法律、法规而被没收押金、课以罚款等则不属于坏账风险范畴。

上市申报中介机构服务费，属于暂挂账性质，不涉及以后期间收回，根据准则规定视发行人 IPO 发行是否成功，冲销资本溢价或计入当期损益。

综上，发行人采用余额百分比法计提坏账准备的项目坏账发生风险很低，采用余额百分比法计提的坏账准备能覆盖坏账发生风险。

**（四）问询回复问题第 42 中，发行人回复报告期内变更了部分会计政策及核算方法，但在保荐机构及申报会计师核查意见中认定，除《企业会计准则》发布及法规变化要求以外，报告期内不存在会计政策变更或会计估计变更的情况**

申报会计师对第一次审核问询函七、42 回复时，描述“……并参考同行业的会计政策，变更了部分会计政策和核算方法，并于报告期进行了会计政策追溯调整。”以及后期的核查意见中，对于表达变更会计政策及核算方法的说明有歧义，会计政策描述采用了大外延涵盖了会计估计、会计政策变更及会计差错更正。发行人根据公司的业务模式和企业会计准则的要求，对发行人部分会计估

计（如坏账准备计提比例、固定资产使用年限、无形资产摊销期限）等进行了变更，并自报告期初进行重述，同时更正了部分会计差错并按照国家新发布的会计政策调整报表科目列报，故报告期内，除《企业会计准则》发布及法规变化要求外，不存在其他的会计政策或会计估计变更的情况，报告期内重大会计政策和会计估计具有一致性。

IPO 申报财务报表属于多期并列财务报表，且发行人财务信息系首次向社会公众公开，参照大部分 IPO 企业的财务报告披露情况，为详细对预定报表使用者（社会公众投资者和潜在投资者）披露会计政策变更和前期差错更正信息，在申报报告中，直接按更正后的财务信息进行披露和列报，不单独披露与前期法定财务数据相比的变化情况。主要政策变更、估计变更和差错更正，在原始报表和申报报表的差异报告中具体解释。

申报会计师认为发行人除《企业会计准则》发布及法规变化要求以外，报告期内不存在会计政策变更或会计估计变更的情况。

#### （五）核查程序及核查结论

1、结合发行人存货的构成以及具体经营情况，分析报告期各季度末及年末的各类存货账面金额变动情况，分析报告期内各月主营业务成本波动情况，以及主要产品单位成本变动情况；

2、复核对发行人的存货减值测试计算过程，以验证发行人存货跌价准备计提方法及计算过程准确无误；

3、获取政府补助相关申请文件、政策文件、收款银行回单等，核实发行人收取政府补助金额准确、真实；

4、检查政府补助相关文件，了解政府补助的内容和相关要求，复核发行人对政府补助属于收益相关还是资产相关的分类是否正确，并复核相关会计处理，确定账务处理是否正确；

5、复核采用余额百分比法计提坏账准备的组合系员工暂支备用金、保证金及押金和上市申报中介机构服务费计算过程，评估坏账发生的风险水平；

6、了解员工备用金、押金、保证金等管理办法，抽样检查员工备用金、保证金等后期归还及报销等账务处理凭证；

7、查询其他 IPO 企业披露情况，评估对 IPO 企业会计政策、估计变更及差错更正披露影响。

经核查，发行人会计师认为：（1）发行人持有的原材料目的均为向目标客户按照订单等交付产品，根据发行人原材料可变现净值情况对原材料计提高比例的存货跌价准备符合《企业会计准则》的相关规定，具有合理性；（2）政府补助对发行人报告期内业绩及经营活动现金净流量的影响较大，报告期后持续获得相同规模的政府补助具有不确定性，报告期发行人取得的政府补助多数为与资产相关的政府补助，将在资产使用寿命内平均计入当年损益，在资产使用寿命期间内政府补助计入当期损益的金额较为稳定；（3）发行人员工暂支备用金、保证金及押金等项目坏账发生风险很低，故采用余额百分比法计提坏账准备，计提的坏账准备能覆盖坏账发生风险；（4）发行人除《企业会计准则》发布及法规变化要求以外，报告期内不存在会计政策变更或会计估计变更的情况，参照大部分 IPO 企业的财务报告披露情况，不需要在招股说明书及财务报告相应部分补充披露报告期内会计政策变更具体情况。

专此说明，请予察核。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

王书阁



中国注册会计师：

李东昕



二〇一九年五月二十四日